

证券代码：600355

证券简称：*ST 精伦

公告编号：临 2026-020

精伦电子股份有限公司 关于申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请综合授信的议案》。具体事项公告如下：

公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币 2000 万元，授信期限为壹年，以我公司自有房产和土地（《不动产权证书》号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0131990 号）做抵押，此综合授信用于流动资金周转。公司董事会授权管理层签订相关合同，具体内容以最终签署合同为准。

公司本次向银行申请综合授信是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日